



## 2024年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年10月31日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東  
コード番号 6920 URL <https://www.lasertec.co.jp/>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 岡林 理  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 (氏名) 三澤 祐太郎 TEL 045-478-7111  
四半期報告書提出予定日 2023年11月10日 配当支払開始予定日 -  
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年6月期第1四半期の連結業績（2023年7月1日～2023年9月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年6月期第1四半期	47,305	83.9	10,279	20.8	10,929	18.3	7,702	14.4
2023年6月期第1四半期	25,723	182.4	8,508	321.3	9,238	330.7	6,731	329.3

(注) 包括利益 2024年6月期第1四半期 7,744百万円 (13.4%) 2023年6月期第1四半期 6,827百万円 (528.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年6月期第1四半期	85.40	85.33
2023年6月期第1四半期	74.64	74.58

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年6月期第1四半期	255,256	105,343	41.3	1,167.86
2023年6月期	271,574	109,142	40.2	1,209.99

(参考) 自己資本 2024年6月期第1四半期 105,322百万円 2023年6月期 109,121百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年6月期	-	52.00	-	128.00	180.00
2024年6月期	-	-	-	-	-
2024年6月期(予想)	-	73.00	-	110.00	183.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2024年6月期の連結業績予想（2023年7月1日～2024年6月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	190,000	24.3	64,000	2.7	64,000	0.5	47,000	1.8	521.16

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年6月期1Q	94,286,400株	2023年6月期	94,286,400株
② 期末自己株式数	2024年6月期1Q	4,102,599株	2023年6月期	4,102,594株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年6月期1Q	90,183,802株	2023年6月期1Q	90,180,704株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	3
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
3. 補足情報 .....	9
(1) 品目別生産実績 .....	9
(2) 品目別受注高及び受注残高 .....	9
(3) 品目別販売実績 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、エネルギーや原材料価格の高騰に伴うインフレ圧力の高止まりに加え、世界的な金融引き締めにより景気減速が懸念されました。また、欧米諸国の政策金利引き上げなどにより歴史的な円安水準となり、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、スマートフォンやパソコンを中心とした最終需要が一巡したことにより、サプライチェーン全体で設備投資の調整局面が続きました。最先端のEUV（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造能力の増強や次世代製造工程の開発に係る投資は一定の水準で実施されたものの、メモリおよびロジックデバイスメーカーの多くは設備投資に対して慎重な姿勢を継続しました。一方で、脱炭素社会の実現に向けたパワー半導体関連や、生成AI向けHBM（広帯域メモリ）など特定分野への投資は堅調に推移しました。

半導体市場は生成AIや普及が進みつつある電気自動車など、さまざまな用途で中長期的に拡大すると予想されており、高まる地政学リスクへの備えという要因も加わって、世界各地で半導体工場の新設・増設計画も推進されています。また、半導体デバイスの製造工程では、継続的な微細化による高性能化や消費電力の低減が求められており、半導体製造装置市場も中長期的に成長を続けると見込まれております。

当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては473億5百万円（前年同期比83.9%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が417億81百万円（前年同期比94.8%増加）、その他が1億55百万円（前年同期比21.4%増加）、サービスが53億68百万円（前年同期比29.4%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が102億79百万円（前年同期比20.8%増加）、経常利益が109億29百万円（前年同期比18.3%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が77億2百万円（前年同期比14.4%増加）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ①財政状態

当第1四半期連結会計期間末における総資産は2,552億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ163億18百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が123億98百万円、原材料及び貯蔵品が30億89百万円増加したものの、未収入金が176億23百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が94億35百万円、仕掛品が49億96百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、当第1四半期連結会計期間末残高は1,499億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ125億18百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が100億円、前受金が42億51百万円増加したものの、有償支給取引に係る負債が154億27百万円、未払法人税等が128億17百万円減少したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は1,053億43百万円となり、また自己資本比率は41.3%となりました。

#### ②キャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ123億98百万円増加し、421億71百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、145億49百万円の収入（前年同期比8.6%増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益109億29百万円、売上債権の減少額95億25百万円、前受金の増加額33億15百万円、棚卸資産の減少額19億78百万円などの収入要因が、法人税等の支払額145億12百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、12億64百万円の支出（前年同期比92.7%減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億21百万円、無形固定資産の取得による支出4億39百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、15億46百万円の支出（前年同期は141億36百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払額115億43百万円などの支出要因が、短期借入金の増加額100億円などの収入要因を上回ったことによるものであります。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年6月期連結業績予想につきましては、2023年8月7日に公表した予想から変更はありません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	29,773	42,171
受取手形、売掛金及び契約資産	21,611	12,176
仕掛品	131,056	126,059
原材料及び貯蔵品	21,017	24,106
未収入金	19,640	2,017
その他	8,029	10,255
貸倒引当金	△38	△13
流動資産合計	231,090	216,774
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,824	10,685
機械装置及び運搬具(純額)	3,468	3,148
工具、器具及び備品(純額)	834	951
リース資産(純額)	37	54
土地	13,146	13,146
建設仮勘定	113	69
有形固定資産合計	28,424	28,055
無形固定資産	6,164	5,678
投資その他の資産		
投資有価証券	1,625	1,425
退職給付に係る資産	56	1
繰延税金資産	3,892	3,002
その他	320	319
投資その他の資産合計	5,895	4,748
固定資産合計	40,484	38,482
資産合計	271,574	255,256

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	17,034	15,317
短期借入金	5,000	15,000
未払法人税等	15,867	3,049
前受金	95,155	99,406
繰延収益	6,168	9,873
賞与引当金	237	1,513
役員賞与引当金	906	173
有償支給取引に係る負債	15,458	31
その他	5,609	4,453
流動負債合計	161,438	148,819
固定負債		
退職給付に係る負債	455	450
株式給付引当金	267	357
資産除去債務	224	223
その他	46	61
固定負債合計	993	1,093
負債合計	162,432	149,913
純資産の部		
株主資本		
資本金	931	931
資本剰余金	1,207	1,207
利益剰余金	105,551	101,709
自己株式	△977	△977
株主資本合計	106,712	102,870
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,041	901
為替換算調整勘定	1,369	1,551
退職給付に係る調整累計額	△1	△1
その他の包括利益累計額合計	2,409	2,451
新株予約権	21	21
純資産合計	109,142	105,343
負債純資産合計	271,574	255,256

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
売上高	25,723	47,305
売上原価	11,275	30,217
売上総利益	14,448	17,087
販売費及び一般管理費	5,940	6,807
営業利益	8,508	10,279
営業外収益		
受取利息	1	10
為替差益	731	642
その他	4	2
営業外収益合計	737	655
営業外費用		
支払利息	7	4
その他	0	0
営業外費用合計	7	5
経常利益	9,238	10,929
税金等調整前四半期純利益	9,238	10,929
法人税、住民税及び事業税	2,845	2,272
法人税等調整額	△337	955
法人税等合計	2,507	3,227
四半期純利益	6,731	7,702
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,731	7,702

(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	6,731	7,702
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	68	△139
為替換算調整勘定	27	182
退職給付に係る調整額	—	0
その他の包括利益合計	96	42
四半期包括利益	6,827	7,744
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,827	7,744
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	9,238	10,929
減価償却費	698	1,078
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7	△25
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,071	1,266
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△628	△732
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△4	△4
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	49	87
受取利息及び受取配当金	△1	△10
支払利息	7	4
為替差損益 (△は益)	△610	△167
売上債権の増減額 (△は増加)	△4,856	9,525
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△15,789	1,978
仕入債務の増減額 (△は減少)	526	440
前受金の増減額 (△は減少)	27,111	3,315
その他	651	1,370
小計	17,470	29,055
利息及び配当金の受取額	1	10
利息の支払額	△7	△4
法人税等の支払額	△4,074	△14,512
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>13,391</b>	<b>14,549</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△17,346	△821
無形固定資産の取得による支出	△73	△439
差入保証金の差入による支出	△9	△4
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△17,429</b>	<b>△1,264</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	20,000	10,000
配当金の支払額	△5,861	△11,543
その他	△1	△2
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>14,136</b>	<b>△1,546</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,384	659
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	11,482	12,398
現金及び現金同等物の期首残高	23,420	29,773
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	209	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,113	42,171

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

## 3. 補足情報

## (1) 品目別生産実績

第1四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	74,407	46,364	△37.7
	その他	657	952	44.7
	小計	75,065	47,316	△37.0
サービス		4,147	5,368	29.4
合計		79,212	52,685	△33.5

(注) 金額は販売価格で表示しております。

## (2) 品目別受注高及び受注残高

第1四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		受 注 高			受 注 残 高		
		前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率	前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率
製 品		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
	半導体関連装置	55,962	35,893	△35.9	398,624	384,575	△3.5
	その他	433	195	△54.8	2,837	6,615	133.2
	小計	56,395	36,089	△36.0	401,461	391,190	△2.6
サービス		6,821	4,677	△31.4	5,234	5,205	△0.6
合計		63,216	40,767	△35.5	406,696	396,395	△2.5

(注) 1. 金額は販売価格で表示しております。

2. 受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。

## (3) 品目別販売実績

第1四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	21,448	41,781	94.8
	その他	127	155	21.4
	小計	21,576	41,936	94.4
サービス		4,147	5,368	29.4
合計		25,723	47,305	83.9